



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23777X

Issue Date:06 Jan 2021

Title of Change:	Transfer of Assembly and Test operations of TO-126 packaged products from AUK-Dalian to SHEDCL, and EMC change from Samsung ST-7100KS to KCC KTM3097GXB for TO-126 package in SHEDCL.	
Proposed First Ship date:	26 Apr 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or NurulAliaFatin.Redzoan@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Jing.Wang2@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified by date code	
Change Category:	Test Change, Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	AUK-Dalian	
	SHANTOU HUASHAN Electronic Devices Co., Ltd., China	
Description and Purpose:		
<p>ON Semiconductor wishes to inform our customers of a change in assembly and test operations of TO-126 packaged products from AUK-Dalian (China) to SHANTOU HUASHAN Electronic Devices (SHEDCL), and EMC change from Samsung ST-7100KS to KCC KTM3097GXB for TO-126 package in SHEDCL.</p> <p>These changes are a result of AUK-Dalian closure and EMC End of Life notification received from Samsung for several of their SDI Mold Compounds. Due to the discontinuance AUKD site and SDI mold compounds, ON Semiconductor will only have limited supplies of the existing material and in some cases this may not allow for the normal change notification period.</p> <p>All other aspects of the impacted products (form, fit, function) will remain unchanged.</p>		
	Before Change Description	After Change Description
Assembly & Test Site	AUK-Dalian SHEDCL	SHEDCL
Mold Compound	ST7100KS	KTM3097GXB

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME: KSE13003H1ASTU

RMS: J71986, O70096

PACKAGE: TO126 3L AU SNGL PBF

Test	Specification	Condition	Interval	Results
EV	JEDS22 B101	External Visual, Device construction, marking, and workmanship		0/231
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150°C, 100% rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JEDS22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45
PD	JESD22 B100	Per POD / Case Outline, Verify physical dimensions to specifications	0 hr	0/30
SAT	J-STD-035		0 hr	0/75
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following TC	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HTRB	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following H3TRB	1008 hrs	0/6
ED	Electrical Distribution / Characterization	Tri Temperature, Per 48A	0 hr	0/30
TR	JESD-24-3, 24-4, 24-6 as appropriate	per device specification, pre & post process change	0 hr	0/10

QV DEVICE NAME: FJES304DTU

RMS: 71457

PACKAGE: TO126 3L AU SNGL PBF

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj for device, bias = 80% of rated V	1008hrs	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device for 1008 hrs	1008hrs	0/240
HAST	JESD22 A110	110°C/85%RH for 264 hrs, bias=80% of rated BV, max=100V	264hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000cycle	0/240
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C max, Ton=Toff is pkg dependent	15000cycle	0/120
UHAST	JESD22 A118	110°C /85%RH for 264 hrs	264hrs	0/240
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell	10s	0/90
SD	J STD 002	Ta=245C 5 sec dwell	5s	0/45

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
KSE13003H1ASTU	KSE13003H1ASTU
KSE13003H2ASTU	KSE13003H1ASTU



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23777X

Issue Date:06 Jan 2021

FJE3303H1TU	KSE13003H1ASTU
FJE5304DTU	FJE5304DTU
FJE5304D	FJE5304DTU
BD17516STU	KSE13003H1ASTU
FJE3303H2TU	KSE13003H1ASTU
KSD794AYSTU	KSE13003H1ASTU
MJE181STU	KSE13003H1ASTU
BD17510STU	KSE13003H1ASTU
KSC2752OSTU	KSE13003H1ASTU

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN23777X

発行日 : 06 Jan 2021

変更件名:	TO-126 パッケージ製品の組立および検査オペレーションを AUK 大連から SHEDCL に移管、および SHEDCL における TO-126 パッケージの EMC を Samsung ST-7100KS から KCC KTMC3097GXB に変更	
初回出荷予定日:	26 Apr 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < NurulAliaFatin.Redzoan@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	最寄りのオン・セミコンダクター営業所または < Jing.Wang2@onsemi.com > にお問い合わせください	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ:	検査の変更, 組立の変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし	AUK-Dalian	
	SHANTOU HUASHAN Electronic Devices Co., Ltd., China	
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクターは、TO-126 パッケージ製品の組立および検査オペレーションを AUK 大連 (中国) から SHANTOU HUASHAN Electronic Devices (SHEDCL) に移管し、SHEDCL では TO-126 パッケージの EMC が Samsung ST-7100KS から KCC KTMC3097GXB に変更されることを、お客様にお知らせします。</p> <p>これらの変更は、AUK 大連の閉鎖、および SDI モールドコンパウンドのいくつかについて Samsung から受けた EMC 生産終了の通知によるものです。AUK 大連拠点の閉鎖と SDI モールドコンパウンドの製造終了に伴い、既存の材料の供給量が限られるため、オン・セミコンダクターは通常の変更通知期間を確保することが不可能になる場合もあります。</p> <p>対象製品のその他の特性 (形状、適合性、機能) については変更ありません。</p>	
	変更前の表記	変更後の表記
組立および検査拠点	AUK-Dalian SHEDCL	SHEDCL
モールド・コンパウンド	ST7100KS	KTMC3097GXB



信頼性データの要約:

デバイス名: KSE13003H1ASTURMS : J71986, O70096パッケージ: TO126 3L AU SNGL PBF

テスト	仕様	条件	間隔	結果
EV	JESD22 B101	External Visual, Device construction, marking, and workmanship		0/231
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150°C, 100% rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45
PD	JESD22 B100	Per POD / Case Outline, Verify physical dimensions to specifications	0 hr	0/30
SAT	J-STD-035		0 hr	0/75
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following TC	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following HTRB	1008 hrs	0/6
DPA	AEC Q101-004 Section 4	Following H3TRB	1008 hrs	0/6
ED	Electrical Distribution / Characterization	Tri Temperature, Per 48A	0 hr	0/30
TR	JESD-24-3, 24-4, 24-6 as appropriate	per device specification, pre & post process change	0 hr	0/10

デバイス名: FJE5304DTURMS : 71457パッケージ: TO126 3L AU SNGL PBF

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj for device, bias = 80% of rated V	1008hrs	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device for 1008 hrs	1008hrs	0/240
HAST	JESD22 A110	110°C/85%RH for 264 hrs, bias=80% of rated BV, max=100V	264hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000cycle	0/240
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C max, Ton=Toff is pkg dependent	15000cycle	0/120
UHAST	JESD22 A118	110°C /85%RH for 264 hrs	264hrs	0/240
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell	10s	0/90
SD	J STD 002	Ta=245C 5 sec dwell	5s	0/45

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23777X

発行日: 06 Jan 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
KSE13003H1ASTU	KSE13003H1ASTU
KSE13003H2ASTU	KSE13003H1ASTU
FJE3303H1TU	KSE13003H1ASTU
FJE5304DTU	FJE5304DTU
FJE5304D	FJE5304DTU
BD17516STU	KSE13003H1ASTU
FJE3303H2TU	KSE13003H1ASTU
KSD794AYSTU	KSE13003H1ASTU
MJE181STU	KSE13003H1ASTU
BD17510STU	KSE13003H1ASTU
KSC2752OSTU	KSE13003H1ASTU



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
KSE13003H1ASTU		KSE13003H1ASTU	NA	
KSE13003H2ASTU		KSE13003H1ASTU	NA	
MJE181STU		KSE13003H1ASTU	NA	
KSC2752OSTU		KSE13003H1ASTU	NA	
FJE3303H1TU		KSE13003H1ASTU	NA	
BD17516STU		KSE13003H1ASTU	NA	